

Technical Data Sheet

双组分导热硅凝胶

SS268D



SS268D 是一款膏状间隙填充材料，按1:1(质量比)混合后固化成高性能弹性体，随结构形状成型，具备最优异的结构适用性和结构件表面贴服特性。使用时满足低应力、高压缩模量的需求，可实现自动化生产。材料与电子产品组装时表现出较低的接触热阻和高电气绝缘性。健康环保，符合RoHS 要求。

主要用途

用于通讯设施、汽车电子、存储设备、消费电子、计算机和外围设备，具有绝缘散热，防水防潮等作用。

产品特性

- 1.导热率:2.0 W/(m.K)
- 2.低应力，高压缩比
- 3.不规则结构间隙应用效果好
- 4.高电气绝缘性
- 5.优良的机械性能及耐候性

技术参数

固化前特性

A 组分			
性能	标准	范围	典型值
颜色	目测	蓝色	---
粘度 mPa.s Brookfield,14#, 10rpm	GB/T 2794	120000±20000	130000
密度 g/cm ³	GB/T 13354	2.0±0.1	2.05

B 组分			
性能	标准	范围	典型值
颜色	目测	黄色	---
粘度 mPa.s Brookfield,14#, 10rpm	GB/T 2794	120000±20000	135000
密度 g/cm ³	GB/T 13354	2.0±0.1	2.04

混合特性

性能	标准	范围	典型值
配比	体积比	A:B=1:1	---
颜色	目测	绿色	---
粘度 mPa.s Brookfield,14#, 10rpm	GB/T 2794	120000±20000	132500
密度 g/cm ³	GB/T 13354	2.0±0.1	2.05
可操作时间 min	---	40-60 (可调)	60

固化后特性

性能	标准	范围	典型值
硬度 Shore 00	GB/T 531.1	60±10	60
介电常数 @100kHz	GB/T 1409	≤7.0	7

Technical Data Sheet

双组分导热硅凝胶

SS268D



击穿电压 KV/mm	GB/T 1408.1	≥ 10	10
导热系数 W/m.k	ASTM D 5470	2.0 ± 0.1	2.05
体积电阻率 $\Omega \cdot \text{cm}$	ASTM D 257	$\geq 10^{12}$	1.62×10^{12}
阻燃性能 (UL-94)	ANSI/UL-94	V-0	V-0
工作温度 $^{\circ}\text{C}$	---	-50~+150	---
以上典型值数据均为 25 $^{\circ}\text{C}$ 标态下检测数据			

本品可加温固化，不同温度下固化时间参照下表(非规格值):

固化温度	25 $^{\circ}\text{C}$	80 $^{\circ}\text{C}$	100 $^{\circ}\text{C}$
固化时间	480min	30min	20min

使用说明

基材预处理

清洁待粘接表面，使基材表面干燥，清洁。

施工

双管包装：使用时装配静态混合管，进行混胶操作，挤出 8-10cm 长度的初始混合物，确保混合均匀。

将混合物，施加到散热部位。某些材料、化学制剂、固化剂和增塑剂可抑制 SS268-D 导热硅凝胶的固化。

如:

- 1) 有机锡和含有机锡的硅橡胶;
- 2) 硫、聚硫化合物或含硫物品;
- 3) 胺、聚氨酯橡胶或含氨的物品;
- 4) 亚磷或含亚磷的物品;
- 5) 酸性物品(有机酸);
- 6) 助焊剂残留物;

若用胶前怀疑含有上述物质，建议先做样品验证后，再批量生产。

5 加仑及 55 加仑桶装可使用专用计量，若您需要供胶系统，可联系 SEPNA 公司，提供技术支持及解决方案。

储存须知

8-28 $^{\circ}\text{C}$ 阴凉干燥环境密封存储。 贮存期：6 个月。

包装规格

400ml/双管；5 加仑桶装；55 加仑桶装。

注意事项

未用完的产品应立即密封保存，防止吸潮。

远离儿童存放。

建议在通风良好处使用。

若不慎接触眼睛和皮肤，请立即用清水冲洗，并到医院检查。

产品的安全性资料请参阅本产品 MSDS。

特别说明

本资料表中的数据是实验室条件下获得。由于使用条件的差异，使用者有责任根据自身使用条件对本产品进行测试和验证。江苏三纳科技材料有限公司（下文简称：三纳科技）不承担销售三纳科技产品和特定工况下使用三纳科技产品出现的问题，不承担直接、间接或意外损失责任。用户在使用过程中遇到什么问题，可以和三纳科技技术服务部门联系，我们将为您提供一切服务。